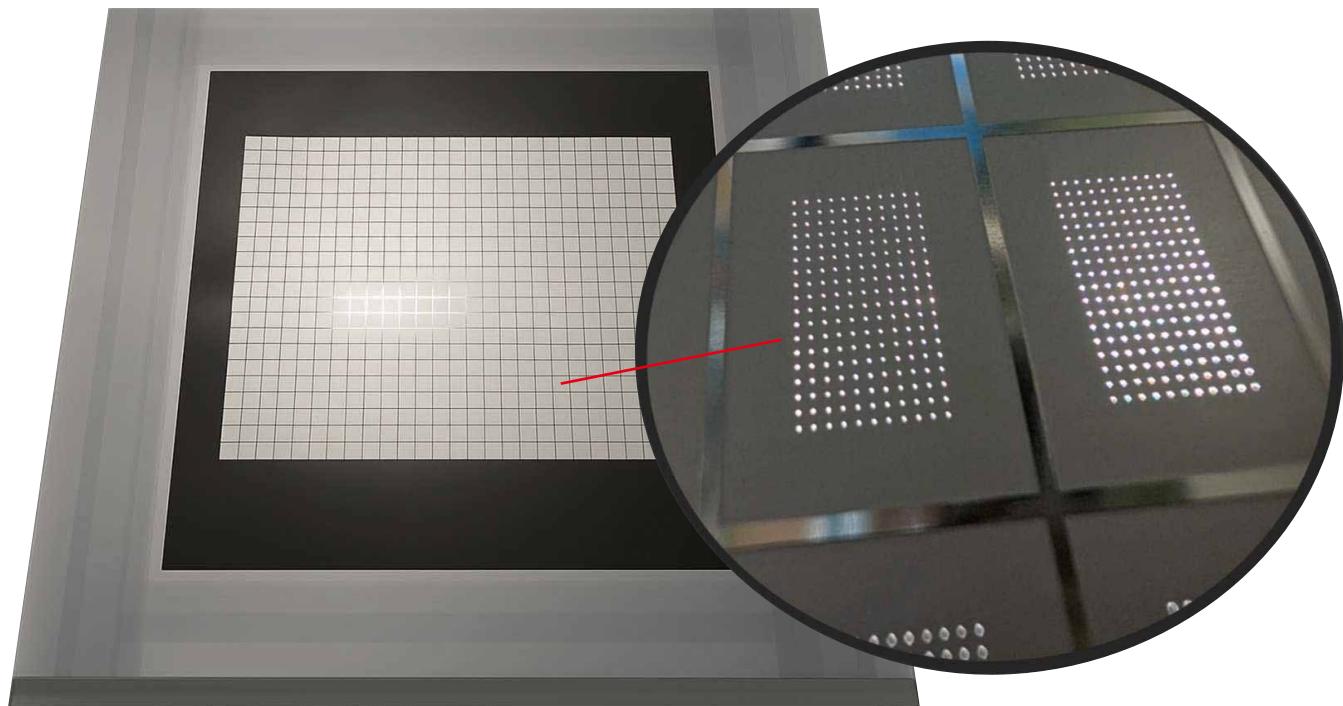


# 半導体パッケージ基板 ボール搭載用 レーザー加工 メタルマスク



## レーザー加工技術の特徴

- 板厚精度が良い！** 積層工程なしで **均一な厚み**
- 短納期対応可能！** シンプル工程だから **最短翌日発送**  
※パターン数により変動
- ローコスト実現！** シンプル工程だから **低価格**

## 比較表

比較項目		アディティブ加工	レーザー加工
QCD	品質	◎	○
	納期	△	○
	価格	○	◎
開口数	多	◎	△
	少	△	◎